

## НОВЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОРПОРАЦИИ MOLEX \*



**В** статье дана краткая информация о выпускаемых корпорацией Molex высокочастотных разъемах Impact™ и гибких кабельных сборках, обеспечивающих высокоскоростную передачу данных.

### NEW HIGH-FREQUENCY COMPONENTS OF CORPORATION MOLEX

**Abstract** – The paper presents a summary of issued with the Corporation Molex Impact™ RF connectors and flexible cable assemblies, providing high-speed data transmission.

#### ГИБКИЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ MOLEX

Гибкие радиочастотные кабельные сборки Molex могут использоваться без ограничений, налагаемых на полужесткий ВЧ-кабель.



Корпорация Molex начала выпуск гибких микроволновых кабельных сборок из коаксиальных кабелей Temp-Flex и высококачественных радиочастотных разъемов Molex, разработанных для замены полужестких и неэластичных соединений. Такие сборки обладают отличными электрическими характеристиками, т.к. обжим разъемов осуществляется по запатентованной технологии, которая минимизирует КСВН.

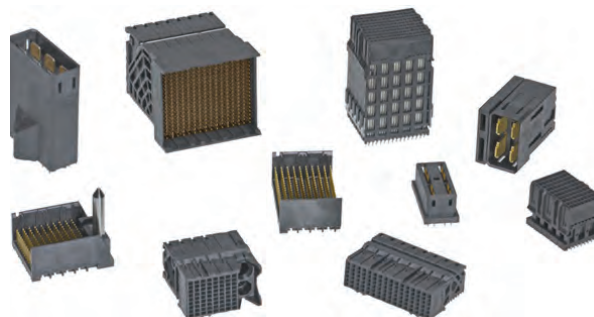
Как широкий спектр стандартных, так и изготовленных по требованиям заказчика сборок, соответствуют Американским и Европейским стандартам, обеспечивая максимально возможную гибкость в конструкции устройства. Это делает сборки Molex идеальным решением в телекоммуникационных устройствах, радиочастотной катетерной абляции, производстве радаров, военной техники, ракет, тестового и измерительного оборудования.

Такие сборки устанавливаются проще, чем полужесткие и обеспечивают более высокую надежность. Стандартные кабели производятся с посеребрённым проводником, фторполимерными (FEP) диэлектриками, двойным экраном и внешним FEP кожухом.

**Low-loss** модификация с одножильным центральным проводником обеспечивает передачу данных со скоростью, равной 70% скорости света (VOP), тогда как **Ultra-low-loss** модификация, в дизайне которой использована уникальная технология воздушного диэлектрика, обеспечивает скорость передачи данных 87% VOP. Кабель сборки имеет импеданс  $50 \pm 1$  Ом и обеспечивает высокую стабильность характеристик. Двойной экран, состоящий из спирально скрученной фольги и плетеного экрана поверх нее, обеспечивает эффективность экранирования 100 дБ, что гарантирует хорошую защиту сигналов от внешних помех.

#### РАЗЪЕМЫ IMPACT™ BACKPLANE CONNECTOR

Серия разъемов Impact™ Backplane Connector (для объединительных плат) с волновым сопротивлением 100 Ом сочетает такие характеристики, как высокая скорость передачи



\* По материалам [www.molex.com](http://www.molex.com)  
Подготовил к печати В. Макаренко.

данных и малые размеры. Модульная система позволяет сформировать из стандартных элементов разъем необходимой конфигурации.

Разъемы Impact™ обеспечивают скорость передачи данных до 25 Гбайт/с, плотность до 80 дифференциальных пар на один дюйм печатной платы при использовании конструкции на 6 дифференциальных пар в одном ряду.

Постоянное увеличение скорости передачи данных в системах связи повышает требования к скорости передачи данных при сохранении целостности сигнала через разъемные соединения. Разъемы Impact™ отвечают этим требованиям, являясь самым эффективным и надежным решением на рынке.

Разработанные с учетом требований завтрашнего дня разъемы Impact™ идеально подходят для высокоскоростного сетевого оборудования и серверов хранения данных в телекоммуникационной, медицинской, военной и аэрокосмической отраслях. Разъемы Impact™ соответствуют требованиям IEEE 10GBASEKR и OIF Stat Eye Compliant end-to-end channel.

Соединители имеют шаг сетки выводов

1.90×1.35 мм, выводы под запрессовку (0.39 и 0.46 мм) позволяют оптимизировать производство печатных плат как для объединительных, так и для дочерних модулей. Дизайн разъема дочерней платы (раздвоенные контакты со ступенчатым расположением) позволяет уменьшить силу сочленения и обеспечивает первичный контакт заземления, не требуя разной длины контактов разъема на основной плате. Разъемы Impact™ доступны в традиционной, копланарной, мезонинной, прямоугольной и ортогональной версиях. Сигнальные модификации разъемов Impact™ различаются конфигурациями, предлагаются от 2 до 6 пар в одном ряду. Силовые модификации доступны от 3 до 6 пар в традиционной, копланарной и мезонинной конфигурациях, с силой тока от 60 до 120 А на каждый модуль.

Использование решения Impact™ от Molex позволяет создавать системы, готовые к увеличению производительности в будущем. Они обеспечивают высокую скорость передачи сигналов, минимизируя "несимметричность" каналов каждой пары внутри устройств.



VD MAIS: 5000 кв.м  
печатных плат в год

## ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

### • производство

VD MAIS – крупнейший поставщик печатных плат на рынке Украины

7 аргументов в пользу печатных плат, поставляемых VD MAIS:

- принцип "все из одних рук"
- стабильное положение фирмы на рынке печатных плат
- высокая квалификация специалистов
- выбор проверенных фирм-изготовителей в зависимости от специфики заказа
- техническое сопровождение проекта при SMD-монтаже
- минимизация цен за счет объединения заказов
- сертификация систем экологического менеджмента и менеджмента качества фирмы согласно требованиям стандартов ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008, предоставление документации по выходному контролю печатных плат

Тел.: (+38-044) 220-0101, 492-8852  
Факс: (+38-044) 220-0202  
E-mail: info@vdmals.kiev.ua  
http://www.vdmals.kiev.ua

**VD MAIS**  
PCB Professionally